

均豪打造智慧機械平台 推動智慧製造

人工智慧(AI)已成為全球產業發展的主要科技之一。面對此波銳不可擋的科技趨勢，均豪精密(5443)整合 39 年來在顯示器、半導體、太陽能等產業推動自動化系統與智慧製造的經驗，運用人工智慧及資訊技術，整合智慧服務功能，打造「均豪智慧機械平台」，協助企業建置智慧工廠，提高生產效率、良率、危機管理應變能力，進而為產品創造加值效益。

均豪總經理陳政興表示，均豪集團供應半導體後段封測設備已近 40 年，兩岸前十大半導體廠商均為均豪集團的主要客戶。因應半導體先進製程需求，以既有八大核心技術為基礎，陸續推出自行研發之「量測及檢測 (Metrology & Inspection) 設備」、「濕蝕刻 (Wet Etching) 設備」、「平面研磨 (Grinding) 設備」以及「智慧物流技術(AGVs)」，提供半導體產業客戶世界級的檢測、量測、清洗及研磨之全方位解決方案並協助客戶建置智慧工廠提升效能，拉近和工業 4.0 的距離。同時，亦積極引進國際大廠 IBM 獨步全球之 PICA 檢測技術，進軍 IC 分析檢測設備。陳政興表示，微光及皮秒影像分析系統(EMMI/PICA)，使用先進微光檢測時間解析及整合(time-resolved and time-integrated emission)技術，廣泛運用於 IC 產品的功能診斷、良率分析、失效分析(F/A)、性能分析及可靠度分析等，可提供半導體元件靜態/動態特性分析所需數據資訊，尤其對於高頻、低耗能、細線化先進製程所需功能提供有效解決方案。

均豪精密在 9 月 13 日至 9 月 15 日為期三天的「SEMICON TAIWAN」展期，將於現場同步展示「平面研磨設備」、「Wafer 2D Inspection 晶圓瑕疵檢查機」二大設備，並自辦技術發表會，歡迎各界蒞臨均豪展場攤位(2726)參觀指導，我們將有專人竭誠為您服務和解說。



均豪精密工業官網 www.gpmcorp.com.tw QR Code

平面研磨設備(Grinding):

具有 Inline 生產、多研磨單元、自動量測、高精度、彈性製造及智慧系統資料分析及回饋功能等特點，將 IC 載板或 Panel fan-out 產品表面 Molding Compound 磨除減薄、平坦化達到產品需求公差，以利後續的製程進行。

Wafer 2D Inspection 晶圓瑕疵檢查機(2D AOI):

可應用於 bumping 段與封測段晶圓切割前後的瑕疵檢測，包含錫球橋接、線路橋接、外物殘留、線路毀損、光阻殘留、刮傷...等，另針對 glass wafer 與 bare wafer 亦提供 Surface Inspection 表面瑕疵檢查與自動分類檢查設備。

均豪自辦技術發表會場次一覽

| Date | Time | Session 1 | Session 2 |
|--------|-------|---|-------------------------------------|
| Sep.13 | 10:30 | IC Wet Bench | PICA/EMMI |
| | 15:30 | Taiko wafer ring cut solution (Sanwa/SYNOVA) | Functional water for SEMI (AVVA) |
| Sep.14 | 10:30 | Batch Etching | PICA/EMMI |
| | 15:00 | Bare Wafer AOI | Wafer 2D AOI |
| Sep.15 | 10:30 | Grinder | PICA/EMMI |
| | 14:00 | Wafer 2D AOI | Smart Sensor Platform |



2D AOI



Grinder